

2026年3月期（第29期） 決算説明資料

2026年5月12日

株式会社バイ・テクノロジー

東京証券取引所 プライム市場 / コード 7717

目次:

1 ハイライト

2 2025年度 連結決算

3 2026年度 連結業績見通し

4 キャピタルアロケーション

5 成長戦略

6 主要財務データ

ハイライト

2025年度 実績

業績概況

- ✓ 半導体・フォトマスク分野売上高が前年同期比32%増、過去最高売上高を達成
- ✓ 利益面ではFPD装置分野の収益性改善が増益に貢献し、営業利益は前年同期比倍増
- ✓ フォトマスク装置、CF露光装置の一部延伸と製品保証関連費用の計上により、公表計画には未達
- ✓ 半導体・フォトマスク受注高は234億円、前年同期比68億円増

受注高 **563億円**

YoY +36億円

売上高 **530億円**

YoY +68億円

営業利益 **38億円**

YoY +19億円

当期利益 **23億円**

(親会社株主帰属)YoY +15億円

ROE **6.6%**

2024年度2.4%

2026年度 見通し

業績概況

- ✓ 半導体・フォトマスク分野売上高は前年同期比60%増と大幅拡大を予想
- ✓ 利益率で半導体・フォトマスク分野がFPD装置分野を上回る見通し
- ✓ 中東情勢が不透明ななか、一定のリスクを費用に織り込む
- ✓ アドバンストパッケージ分野を中心の受注は引き続き増加を想定

受注高

YoY 増加を予想

売上高 **600億円**

YoY +70億円

営業利益 **55億円**

YoY +17億円

当期利益 **30億円**

(親会社株主帰属)YoY +7億円

ROE **8.0%**

2025年度6.6%

2025年度 連結決算

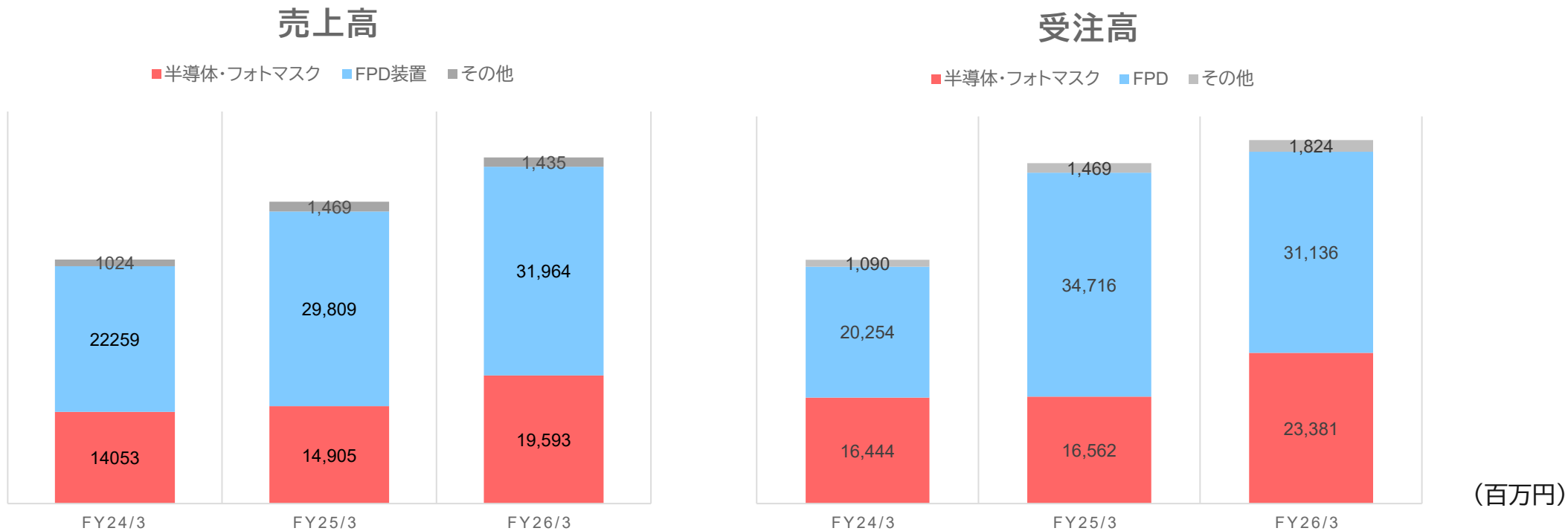
セグメント別 売上高・受注高推移

半導体・
フォトマスク

- ✓ 2025年度受注高はアドバンスパッケージと半導体ウエハ検査装置がけん引
- ✓ 一方、売上高ではこれらが好調な反面、フォトマスクが大幅に減少

FPD装置

- ✓ 2025年度受注高は部品・メンテナンスが増加したものの、CF露光装置等が減少
- ✓ 検査装置は売上高、受注高とも横ばい圏で推移



半導体・フォトマスクとFPDのサブセグメント受注高推移

半導体・
フォトマスク

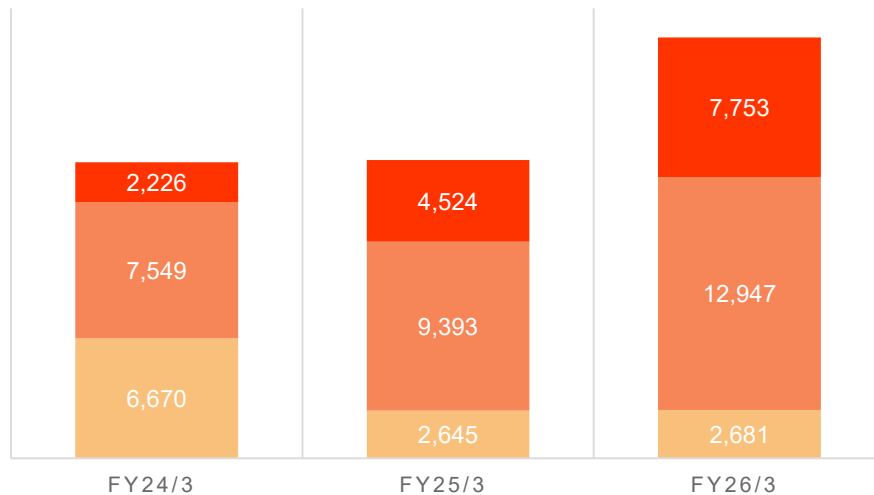
- ✓ アドバンストパッケージはパッケージサブストレート向けDI露光装置の受注が拡大
- ✓ ウエハ検査装置の受注も堅調

FPD装置

- ✓ 部品・メンテナンスが増加したものの、CF露光装置等が一部延伸
- ✓ 検査装置は受注高は相対的に安定

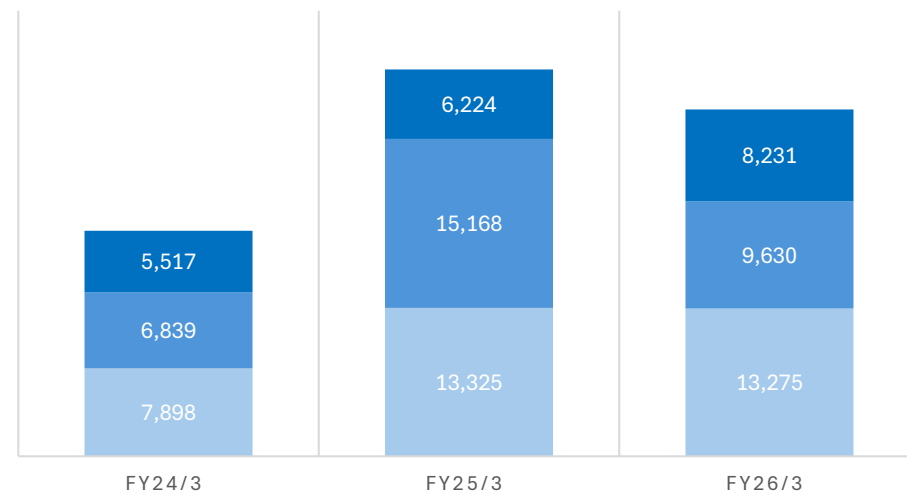
半導体・フォトマスク受注高推移

■ フォトマスク ■ 半導体(ウエハ製造等) ■ アドバンストパッケージ・PCB



FPD装置の受注高推移

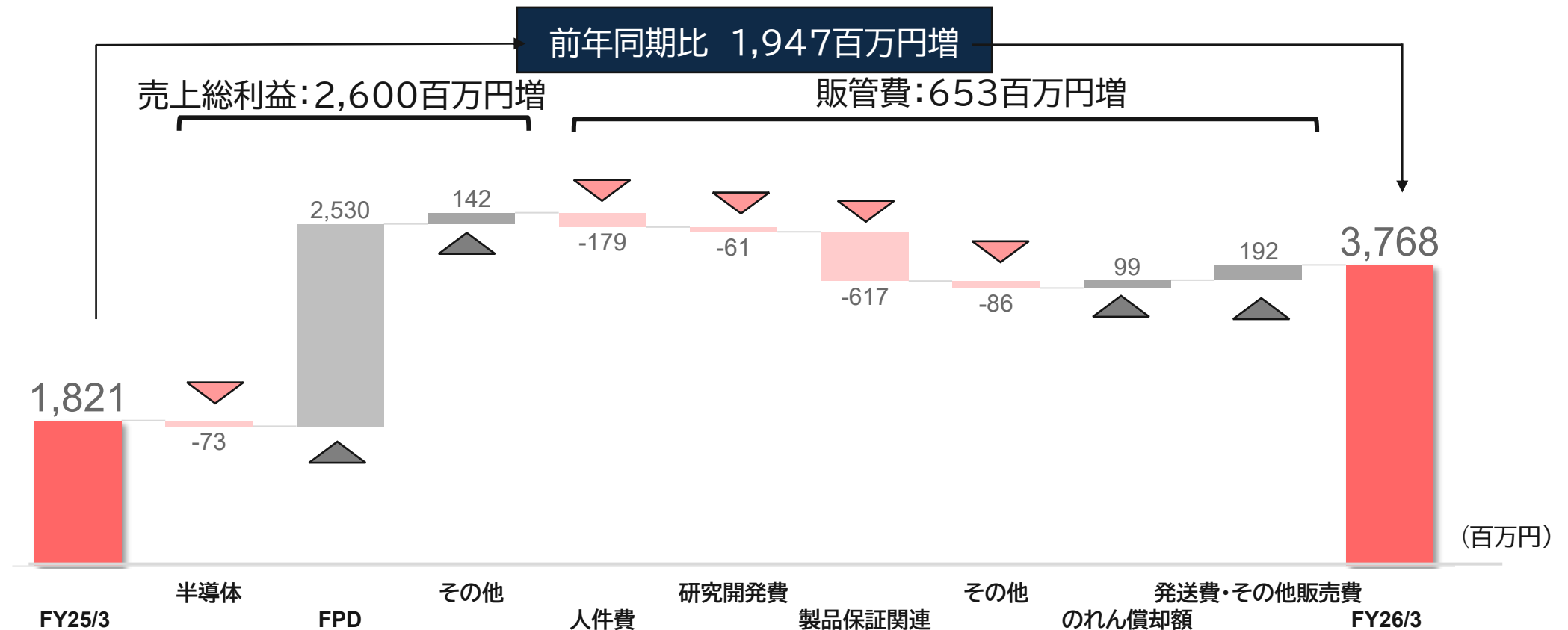
■ 検査 ■ 製造 ■ メンテナンス



(百万円)

営業利益増減要因

- ✓ 半導体・フォトマスクセグメントは大幅増収ながら、フォトマスクの急減、粗利率の低い商社型ビジネスの売上拡大などにより売上総利益の増加に至らなかった
- ✓ 製品保証関連費用は①中国国産化が進むFPD装置②フォトマスク③ウェハ検査装置等において増加



2026年度 連結業績見通し

業績見通し

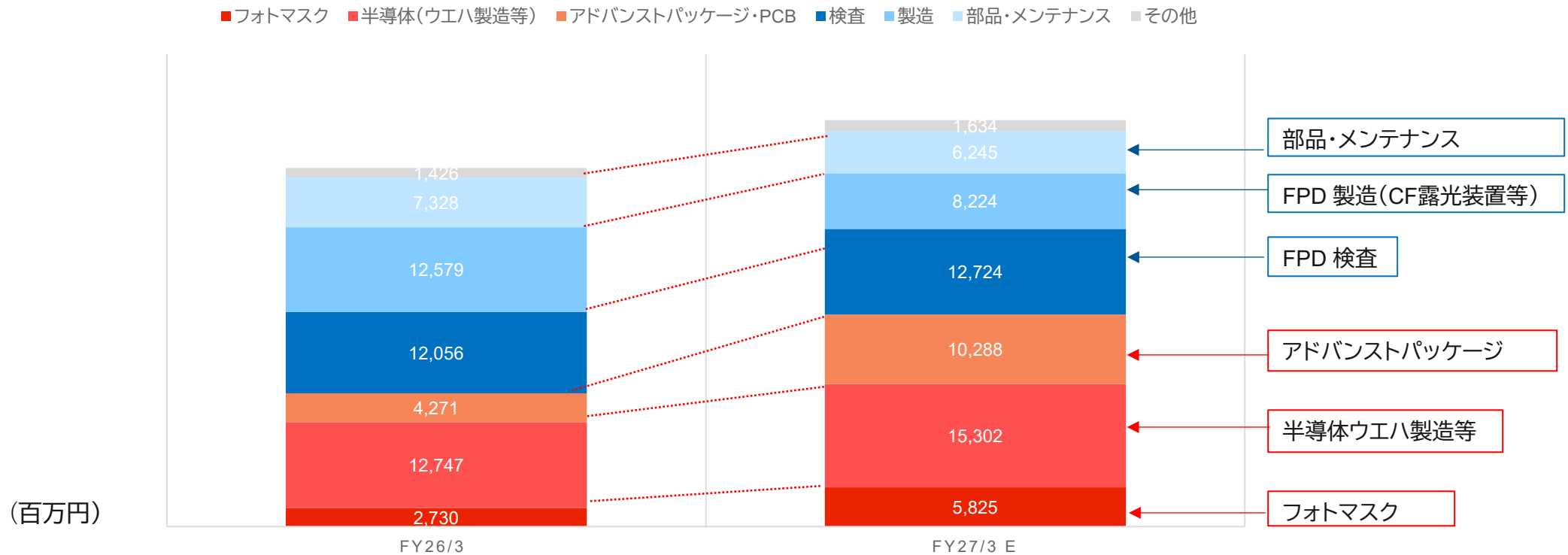
- ✓ 半導体・フォトマスク分野売上高は前年同期比60%増と大幅拡大を予想
- ✓ 利益率で半導体・フォトマスク分野がFPD装置分野を上回る見通し
- ✓ アドバンストパッケージ分野を中心に26年度受注は引き続き増加を想定

(単位:百万円)		2025年度	2026年度予想	増減
売上高		52,992	60,000	+7,008
営業利益		3,768	5,500	+1,732
利益率		7.1%	9.1%	
経常利益		3,474	4,700	+1,226
利益率		6.6%	7.8%	
親会社株主に帰属する当期純利益		2,301	3,000	+699
利益率		4.3%	5.0%	
EPS(円)		243.48	317.35	+73.87
配当(円)	中間	40	40	—
	期末	40	40	—
配当性向		32.9%	25.2%	

セグメント別売上高予想

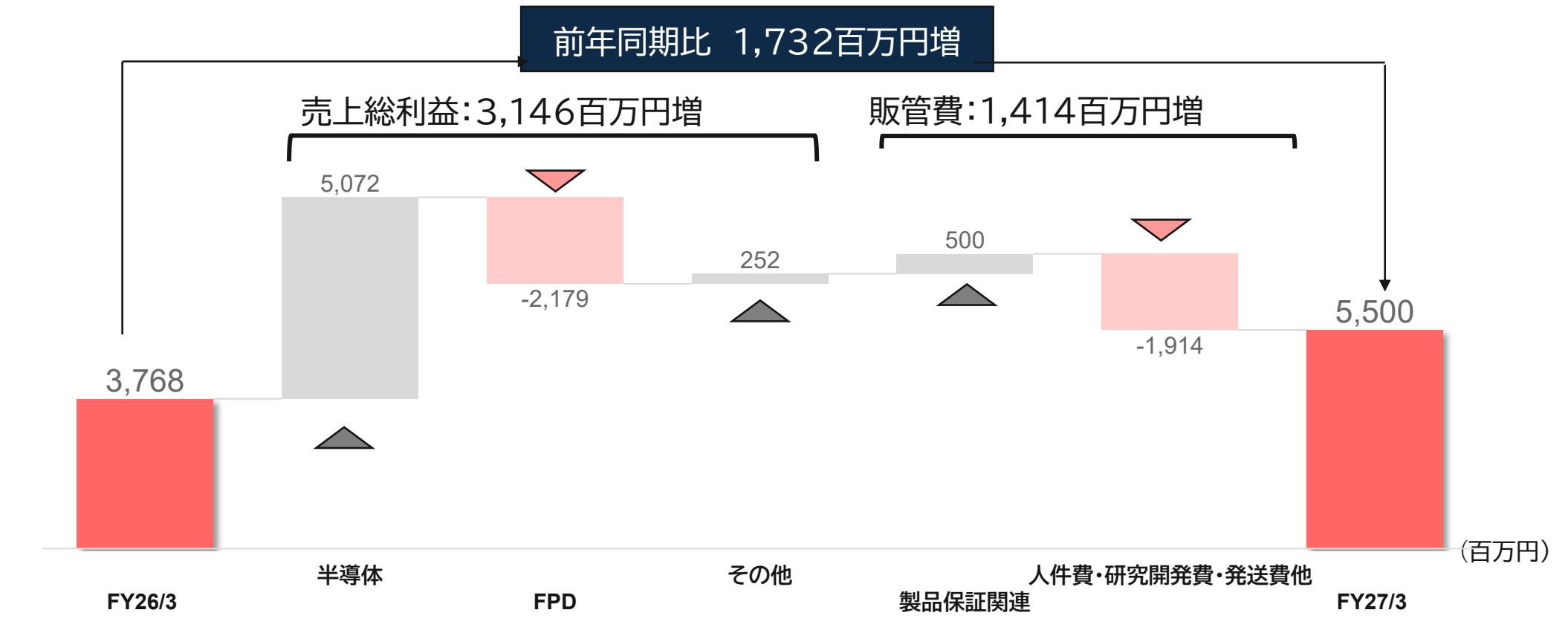
- ✓ 半導体・フォトマスク分野では、アドバンストパッケージでDI露光機の本格拡大が寄与する見通し
- ✓ フォトマスクは25年度の低水準から復調を見込む
- ✓ FPD装置ではCF露光装置の減少が見込まれるものの、検査装置は堅調を予想

セグメント別売上高予想



営業利益見通し

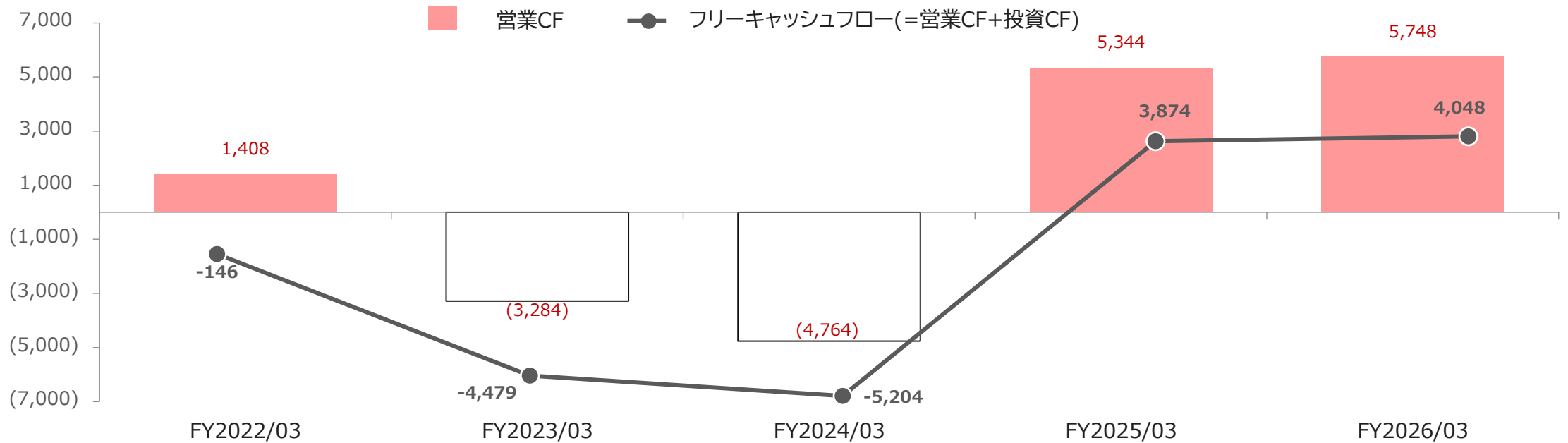
- ✓ 半導体・フォトマスクセグメントでの大幅増収を予想
- ✓ 製品保証関連費用は減少を見込む一方、足元の地政学情勢を踏まえた輸送コスト上昇などを織り込み、販管費は増加



キャピタルアロケーション

営業キャッシュフローの改善に注力

- ✓ 25年度営業キャッシュフローは改善したが、アドバンスパッケージの設置がラッシュの26年度は減少する見通し
- ✓ 装置リードタイム短縮を含めた仕掛品回転月数の短期化等を推進し改善に注力する



(百万円)

業績計画達成に全社的に取り組むと同時に業績結果に応じた株主還元を目指す

- ✓ 事業拡大に向けたM&A、設備投資等、経営基盤の強化に向けて、必要な内部留保の充実を勘案した上で、配当の安定性・継続性・配当性向等を考慮
- ✓ 経営成績に応じた利益還元を行なう方針
- ✓ 年間配当は前期末と同じ80円を計画するが、今期業績結果等を踏まえ積極的な利益還元も検討予定
- ✓ 株主還元の充実を図るため、機動的な自己株式取得等、引き続き検討

項目		FY22/3	FY23/3	FY24/3	FY25/3	FY26/3	FY27/3(予想)
配当金額(総額/百万円)		1,176	882	586	765	765	765
配当性向(%)		30.6	334.7	74.2	95.2	32.9	25.2
一株当たり 配当金(円)	中間	60	60	30	40	40	40
	期末	60	30	30	40	40	40
	総額	120	90	60	80	80	80

ROEは最重要数値目標

25年度の計画未達を重く受け止め、26年度計画必達に向け全社的に取り組む

	FY24/3	FY25/3	FY26/3	FY27/3E	FY29/3E
ROE	2.3%	2.4%	6.6%	8.0%	23.7%

最終利益極大化

売上高の増加

- ✓ アドバンストパッケージ等成長分野へのグループを結集した対応
- ✓ M&Aによる成長事業の創出

利益率のアップ

- ✓ 限界利益率の高い半導体・フォトマスク事業の売上拡大によるミクス改善
- ✓ FPDから半導体にグループ陣容の活用によるグループ内シナジー

株主還元の実施

利益水準に応じた配当拡大

- ✓ 安定配当は大前提だが、利益の拡大局面において、その計画達成確度に応じた増配の意思決定を行う

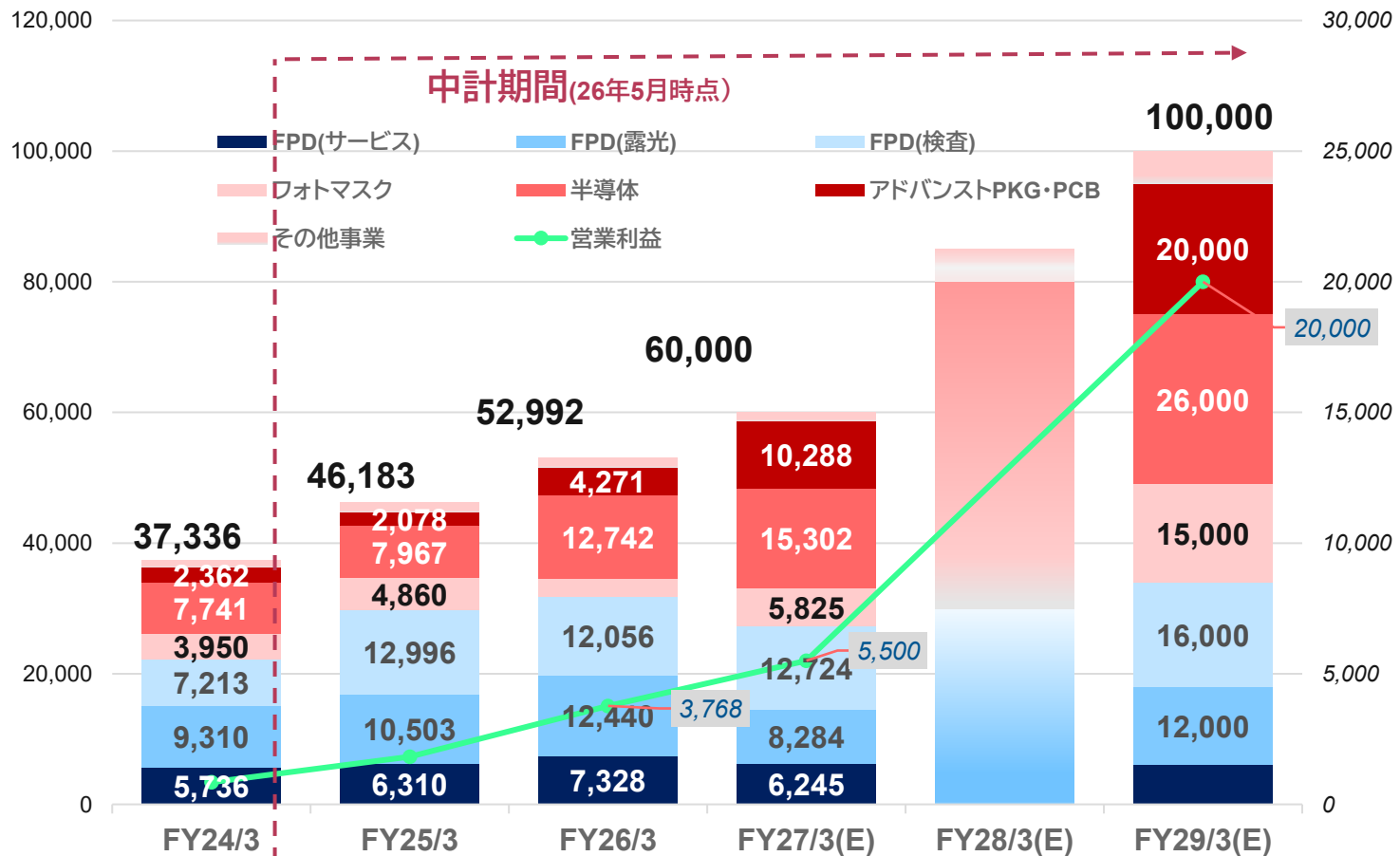
機動的な自社株買い

- ✓ 株主還元は配当を重視するが、収益力と株価を注視し、機動的な自社株買いを実施する

成長戦略

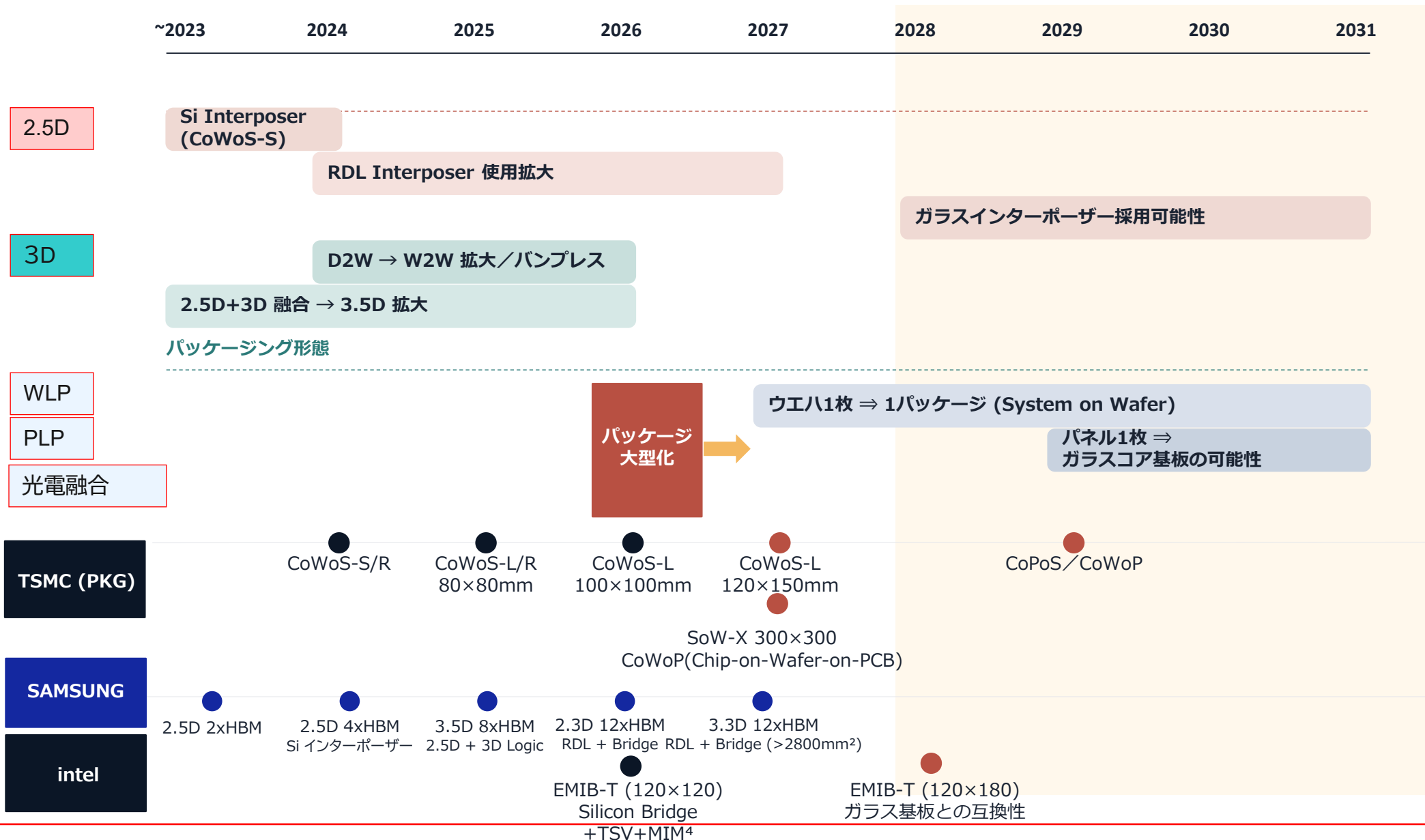
成長戦略: 中期経営計画達成に向けて

2029年3月期の全社目標は維持（セグメント構成は変わる可能性）
達成に向け受注獲得に引き続き邁進



	セグメント	狙う市場	主力製品
半導体 フォトマスク	アドバンストパッケージ・PCB	・半導体パッケージ基板 ・汎用PCB基板	DI露光、O/Sテスター
	半導体	・シリコンウェハ ・フォトレジスト、他	・検査 ・マスクレス露光 ・コーデバ、他
	フォトマスク	・レガシー半導体 ・FPD	検査、修正、測定、他
FPD	検査	LCD、OLED、他	検査、修正、測定、他
	露光	LCD、他	カラーフィルタ-露光 光配向露光、他
	部品・メンテナンス	LCD、OLED、他	納入済製品のサービス

AI半導体向け先端パッケージング技術のロードマップ



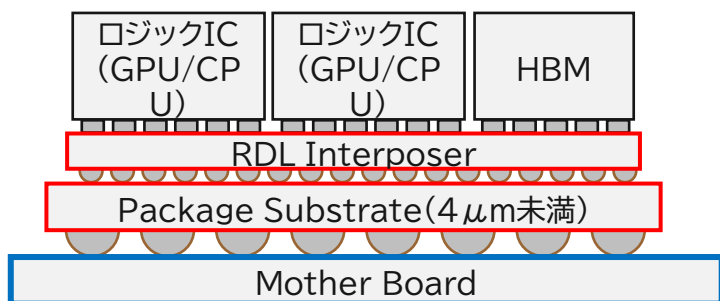
アドバンストパッケージ事業の強化

AI用半導体パッケージの分野に集中 PC/スマホ向けは協業へ

半導体パッケージ

AI用半導体パッケージ(アドバンストパッケージ)

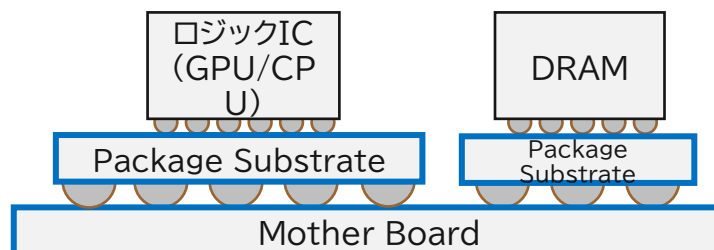
.....チップレット(2. xDパッケージ)



注力分野 (赤枠)

PC、スマートフォン等用半導体パッケージ

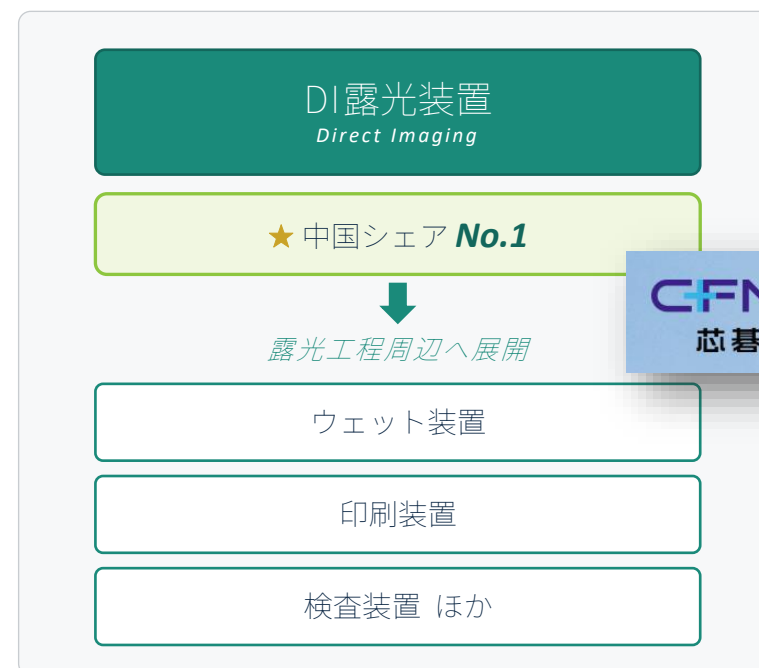
.....FC-BGA、FC-CSP



協業分野 (青枠)

PCB

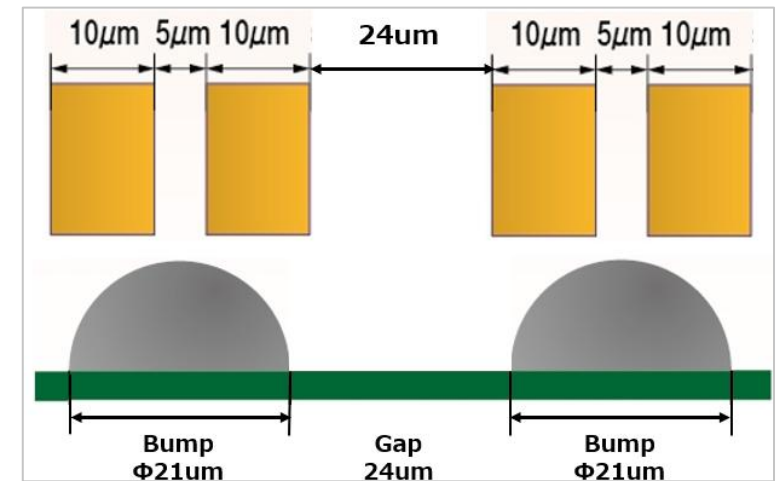
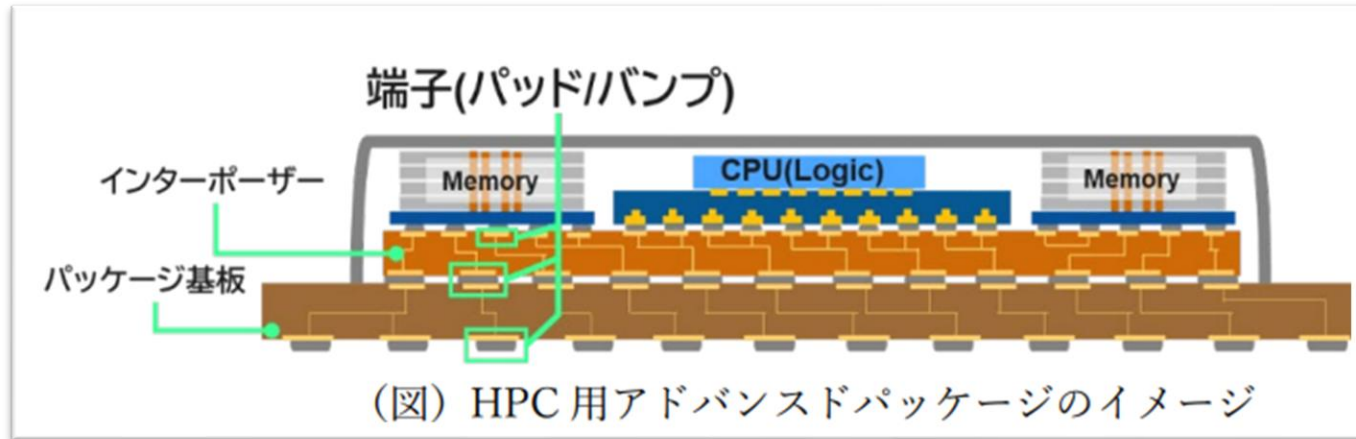
露光の周辺工程へソリューションを展開



アドバンスドパッケージ テスター

テスター「LIBRA」

マイクロプローブ



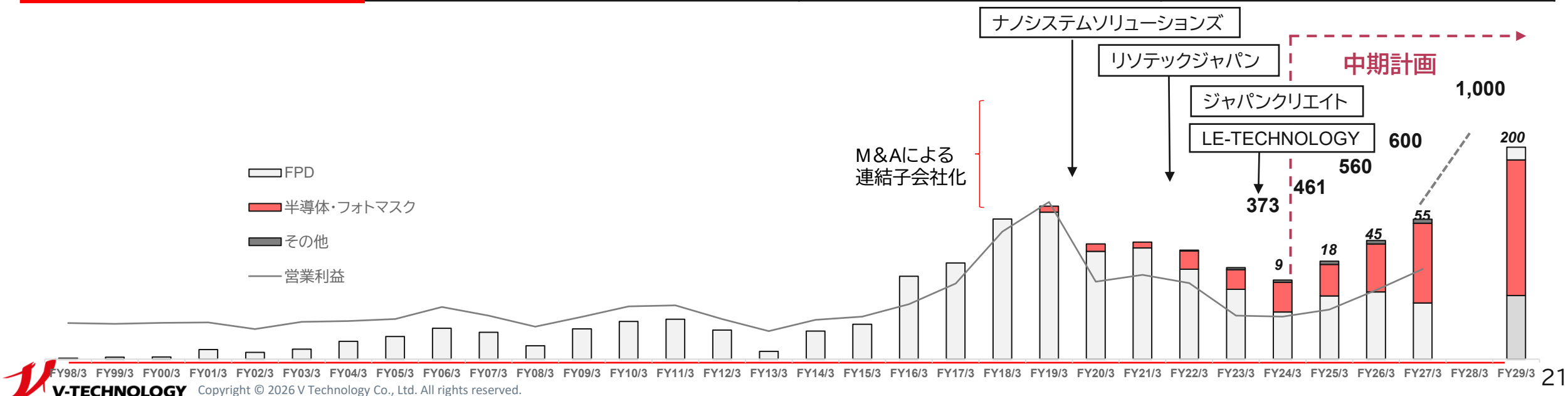
2024年11月25日 PRニュースリリース より

LIBRA は、従来方式の検査で対応が不可能なほどに狭ピッチ化が急速にすすむパッケージ基板・インターポージャー (RDL)上の端子間の電気的な検査を、世界で初めて実現しました。この装置は、配線層を積層する途中工程から完成後の最終検査までに必要とされる多種多様な検査に、当社グループの独自技術を結集して開発した超微細μプローブを採用、量産ラインへの適用が見込まれる 25μm ピッチ端子の4端子検査に業界で初めて対応しています。

成長戦略: FPDから半導体へ、成長ドライバを転換

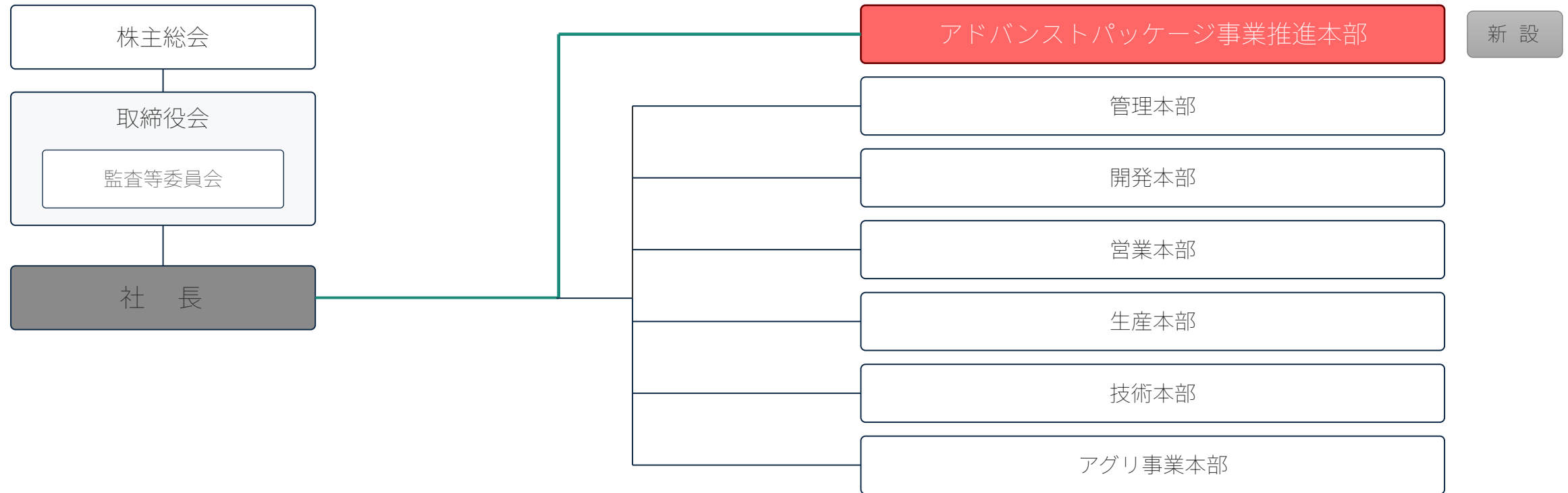
半導体に係る日本が強い分野へ参入・・・装置事業は顧客との共同開発が不可欠

参入市場	業界を代表する企業名	当社グループ	主要製品
シリコンウェハ	信越化学工業、SUMCO、他	ナノシステムソリューションズ ジャパンクリエイト	シリコンウェハ検査、洗浄
フォトマスク	テクセンドフォトマスク、DNP、HOYA、他	ブイ・テクノロジー	検査装置(Vテクオリジナル製品)
レジスト材料	東京応化工業、JSR、信越化学工業、住友化学、富士フイルム、他	リソテックジャパン	研究室用レジスト評価装置
アドバンストパッケージ	イビデン、新光電気工業、TOPPANホールディングス、他	LE-TECHNOLOGY オー・エイチ・ティー	DI露光装置、オープンショートテスタ、マイクロプローブ



組織図

アドバンストパッケージ事業推進本部を創設 推進力強化へ



▶ アドバンストパッケージ事業推進本部は社長直轄の組織として、半導体パッケージ事業のグループ一元運営を担う。

DI露光装置「LAMBDI」をNEDOから受注

アドバンストパッケージ向け — 世界初の解像度を達成

$$L/S = 0.5 \mu\text{m}$$



DI露光装置 LAMBDI Neo01

DI露光装置「LAMBDI」をNEDOから受注

～ アドバンストパッケージ向けで世界初となるL/S=0.5 μm クラスを受注～

株式会社ブイ・テクノロジー（神奈川県横浜市保土ヶ谷区神戸町134 横浜ビジネスパーク イーストタワー9F、代表取締役 杉本 重人、以下「当社」）の連結子会社株式会社LE-TECHNOLOGY（東京都千代田区四番町4-19 CIRCLES市ヶ谷2F、代表取締役社長 李 梶、以下「LET」）は、インターポザーおよびパッケージ基板向けDI（Direct Imaging）露光装置「LAMBDI（ラムディ）」において世界初となるL/S=0.5 μm クラスの開発に成功、この度、NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）から、大阪公立大学を通じて受注いたしました。

当社グループは、2025年8月に1 μm 配線対応のDI露光機の出荷を開始しましたが、さらなる高解像度化を実現、今回の受注に至りました。今後も半導体および電子デバイスの進化を支える革新的な技術の創出に取り組み、社会の発展に貢献してまいります。

2026年4月7日ニュースリリース

1.セグメント別受注高・売上高の詳細(単位:百万円)

項目	FY				FY24/3				FY25/3				FY26/3			
	FY24/3	FY25/3	FY26/3	FY27/3 予想	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
受注	37,788	52,747	56,342	—	9,264	11,210	6,716	10,598	9,880	7,681	8,901	26,285	9,262	8,089	6,291	32,700
半導体・フォトマスク	16,444	16,562	23,381	—	2,592	5,872	2,283	5,763	2,255	4,120	6,037	4,151	3,547	3,800	2,962	13,072
フォトマスク	6,670	2,645	2,681	—	250	2,790	484	3,146	590	700	1,351	4	0	2,040	90	551
半導体(ウエハ製造、ラボ等)	7,549	9,393	12,947	—	2,281	1,988	1,299	1,982	960	2,564	3,151	2,719	2,598	1,746	2,533	6,070
アドバンスパッケージ・PCB	2,226	4,524	7,753	—	63	1,095	500	634	705	856	1,536	1,428	949	14	339	6,451
FPD装置	20,254	34,716	31,136	—	6,433	5,077	4,174	4,569	7,237	3,248	2,511	21,721	5,346	3,957	2,959	18,874
検査	7,898	13,325	13,275	—	1,037	3,604	2,285	973	2,944	1,731	1,137	7,513	1,839	757	1,104	9,575
製造	6,839	15,168	9,630	—	4,339	-1	554	1,948	2,905	0	258	12,005	2,287	1,328	12	6,003
部品・メンテナンス	5,517	6,224	8,231	—	1,058	1,475	1,336	1,649	1,388	1,516	1,116	2,204	1,220	1,872	1,843	3,296
その他	1,090	1,469	1,824	—	239	261	258	266	388	314	354	413	368	332	370	754
半導体・フォトマスク比率	43.5%	31.4%	41.5%	—	28.0%	52.4%	34.0%	54.4%	22.8%	53.6%	67.8%	15.8%	38.3%	47.0%	47.1%	40.0%
受注残高	37,100	43,664	47,013	—	40,162	44,787	44,734	37,100	37,456	32,316	31,737	43,664	44,927	41,271	35,248	47,013
半導体・フォトマスク	17,200	18,857	22,629	—	15,958	19,809	18,162	17,200	17,959	18,168	21,151	18,857	18,087	17,055	19,532	22,629
FPD装置	19,899	24,877	23,986	—	24,204	24,978	26,571	19,899	19,497	14,147	10,586	24,877	26,840	24,216	15,716	23,986
その他	0	0	398	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398
半導体・フォトマスク比率	45.5%	43.2%	48.1%	—	39.7%	44.2%	40.6%	45.5%	47.9%	56.2%	66.6%	43.2%	40.3%	41.3%	44.6%	48.1%
売上	37,336	46,183	52,993	60,000	5,749	6,585	6,769	18,231	9,523	12,822	9,479	14,358	7,999	11,744	12,315	20,935
半導体・フォトマスク	14,053	14,905	19,593	31,415	1,377	2,020	3,931	6,724	1,495	3,911	3,055	6,444	4,317	4,832	4,285	6,159
フォトマスク	3,950	4,860	2,730	5,825	67	270	862	2,751	734	1,687	985	1,455	1,536	119	700	375
半導体(ウエハ製造、ラボ等)	7,741	7,967	4,271	15,302	831	1,377	2,122	3,412	642	2,116	1,542	3,667	1,327	955	1,136	726
アドバンスパッケージ・PCB	2,362	2,078	12,592	10,288	480	374	947	627	120	108	527	1,323	1,454	3,758	2,449	5,058
FPD装置	22,259	29,809	31,963	27,253	4,133	4,303	2,581	11,242	7,639	8,598	6,071	7,501	3,314	6,580	7,648	14,421
検査	7,213	12,996	12,056	12,724	197	308	832	5,876	3,648	3,859	2,895	2,594	2,182	3,772	2,417	3,685
製造	9,310	10,503	12,579	8,284	2,620	2,599	314	3,777	2,591	3,065	1,654	3,193	266	767	3,308	8,238
部品・メンテナンス	5,736	6,310	7,328	6,245	1,316	1,397	1,435	1,588	1,400	1,674	1,522	1,714	866	2,041	1,924	2,497
その他	1,024	1,469	1,436	1,332	239	261	258	266	388	314	354	413	368	332	380	356
半導体・フォトマスク比率	37.6%	32.3%	37.0%	40.5%	24.0%	30.7%	58.1%	36.9%	15.7%	30.5%	32.2%	44.9%	54.0%	41.1%	34.8%	29.4%

(部品・メンテナンスを含む)

2.受注高および業績実績とガイダンス(単位:百万円)

項目	2020/3	2021/3	2022/3	2023/3	2024/3	2025/3	2026/3	2027/3E	2025/3				2026/3			
									1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
受注高	22,532	36,980	53,200	37,072	37,788	52,747	56,342	-	9,879	7,682	8,901	26,285	9,262	8,089	6,291	32,700
受注残高	59,145	40,939	42,721	36,647	37,100	43,664	47,013	-	37,456	32,316	31,737	43,664	44,928	41,271	35,248	47,013
売上高	54,322	55,186	51,418	43,146	37,335	46,182	52,992	60,000	9,523	12,822	9,479	14,358	7,998	11,746	12,313	20,935
売上総利益	15,122	15,704	15,486	10,946	10,604	12,130	14,730	-	1,773	3,375	2,547	4,435	1,854	2,658	3,878	6,340
営業利益	5,653	6,604	5,461	986	846	1,821	3,768	5,500	-948	812	192	1,765	-514	144	997	3,141
営業外収益	623	395	518	935	551	517	731	-	287	-154	353	31	139	59	248	285
営業外費用	121	163	111	222	285	447	1025	-	97	175	76	99	215	19	84	707
経常利益	6,156	6,836	5,868	1,700	1,112	1,891	3,474	4,700	-759	484	469	1,697	-589	183	1,161	2,719
税前利益	6,191	7,054	6,450	1,571	1,181	1,383	3,425	-	-721	504	451	1,149	-633	269	1,417	2,372
法人税等	2,054	2,462	2,194	1,434	603	781	1058	-	-6	101	213	473	60	-194	-131	1,323
親会社株主 当期純利益	3,251	3,513	4,198	260	778	800	2301	3,000	-656	440	269	747	-665	426	1,543	997
1株当たり 当期純利益*	336.29	363.41	434.21	26.92	80.65	84.07	243.48	317.35	-68.22	45.41	5.63	78.44	-70.46	45.13	163.37	105
1株当たり配当金	120	120	120	90	60	80	80	80	-	40	-	40	-	40	-	40
1株当たり純資産	2926.03	3233.74	3534.4	3475.25	3571.35	3544.98	3825.9	-	-	-	-	3544.98	-	-	-	3825.9
売上高総利益率	27.8%	28.5%	30.1%	25.4%	28.4%	26.3%	27.8%	-	18.6%	26.3%	26.9%	30.9%	23.2%	22.6%	31.5%	30.3%
売上高営業利益率	10.4%	12.0%	10.6%	2.3%	2.3%	3.9%	7.1%	9.2%	-10.0%	6.3%	2.0%	12.3%	-6.4%	1.2%	8.1%	15.0%
売上高経常利益率	11.3%	12.4%	11.4%	3.9%	3.0%	4.1%	6.6%	7.8%	-8.0%	3.8%	4.9%	11.8%	-7.4%	1.6%	9.4%	13.0%
法人税率	33.2%	34.9%	34.0%	91.3%	51.1%	56.5%	30.9%	-	0.83%	20.04%	47.23%	41.17%	-9.5%	-72.1%	-9.2%	55.8%
売上高当期純利益率	6.0%	6.4%	8.2%	0.6%	2.1%	1.7%	4.3%	5.0%	-6.9%	3.4%	0.6%	5.2%	-8.3%	3.6%	12.5%	4.8%
自己資本利益率(ROE)	11.5%	11.2%	12.7%	0.8%	2.3%	2.4%	6.6%	8.0%	-2.0%	1.3%	0.2%	2.2%	-2.0%	1.3%	3.8%	2.8%
自己資本	28,293	31,268	32,980	32,842	34,372	33,500	36,080	-	33,611	32,976	33,153	33,500	32,634	33,172	34,699	36,167

*期中平均株式数、自己株式含まず

3.貸借対照表・キャッシュフロー計算書(単位:百万円)

項目	2021/3	2022/3	2023/3	2024/3	2025/3	2026/3	2025/3				2026/3			
							1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
資産の部														
現金及び預金	33,278	27,898	26,729	23,096	26,671	29,475	25,063	28,930	26,196	26,671	23,129	19,952	23,569	29,475
受取手形・売掛金	19,329	19,537	22,408	24,716	19,786	17,494	20,332	21,681	20,181	19,786	18,085	21,598	19,352	17,494
棚卸資産	15,956	11,405	10,089	15,531	15,495	14,200	16,408	15,052	17,057	15,495	18,196	18,131	20,600	14,200
商品及び貯蔵品	196	176	338	477	679	633	443	787	788	679	941	625	1,205	633
仕掛品	13,977	9,428	7,219	12,274	10,707	10,160	12,881	11,374	12,951	10,707	12,612	13,545	15,750	10,160
原材料及び貯蔵品	1,783	1,801	2,532	2,780	4,109	3,407	3,084	2,891	3,318	4,109	4,643	3,961	3,645	3,407
流動資産	71,379	63,085	62,621	67,045	65,392	64,464	65,537	69,073	67,255	65,392	62,922	63,018	67,440	64,464
有形固定資産	4,382	4,720	4,034	4,098	3,859	4,103	4,305	4,261	4,221	3,859	4,403	4,443	4,325	4,103
無形固定資産	1,625	1,495	1,460	886	712	709	1,000	957	879	712	648	586	537	709
投資その他の資産	3,203	3,300	3,270	3,575	3,235	3,771	3,553	3,190	3,105	3,235	3,157	3,619	4,419	3,771
資産合計	80,591	72,601	71,387	75,606	73,201	73,049	74,397	77,483	75,461	73,201	71,132	71,668	76,721	73,049
負債の部														
支払手形・買掛金	6,477	6,323	4,039	5,429	4,918	4,306	5,296	4,778	4,932	4,918	5,735	5,031	6,018	4,306
短期借入金	120	394	663	866	1,295	2,161	1,386	1,704	1,685	1,295	1,297	1,868	1,784	2,161
前受金	15,061	8,334	8,221	4,496	5,037	4,254	5,645	5,638	5,113	5,037	5,563	5,892	5,752	4,254
流動負債	34,195	27,061	23,922	29,299	24,263	22,773	29,905	26,474	25,650	24,263	24,404	25,078	27,054	22,773
長期借入金	12,964	10,243	12,662	10,550	14,254	12,718	9,482	16,745	15,420	14,254	12,819	12,167	13,698	12,718
純資産	32,195	34,540	33,884	34,639	33,581	36,250	33,841	33,154	33,300	33,581	32,691	33,258	34,771	36,250
自己資本	31,268	34,175	33,604	34,372	33,500	36,167	33,611	32,976	33,153	33,500	32,634	33,172	34,699	36,167
連結CF														
営業活動によるCF	20,173	1,408	-3,284	-4,764	5,344	5,748	—	—	—	—	—	—	—	—
投資活動によるCF	-1,251	-1,554	-1,195	-440	-1,470	-1,700	—	—	—	—	—	—	—	—
フリーキャッシュ・フロー	18,922	-146	-4,479	-5,204	3,874	4,048	—	—	—	—	—	—	—	—
自己株式取得	-512	0	0	-99	-499	0	—	—	—	—	—	—	—	—
配当金支払額	-974	-1,176	-1,176	-588	-675	-765	—	—	—	—	—	—	—	—
財務活動によるCF	1,972	-5,839	2,780	1,526	-471	-1704	—	—	—	—	—	—	—	—

事業セグメントについて

事業セグメント	サブセグメント	関連市場	主力製品	ブイ・テクノロジーグループ
半導体・ フォトマスク	アドバンストパッケージ・ PCB	・アドバンストパッケージ ・汎用PCB基板	・DI露光 ・O/Sテスター	<ul style="list-style-type: none"> LE-TECHNOLOGY オー・エイチ・ティー ブイ・テクノロジー
	半導体	・シリコンウェハ ・フォトレジスト ・半導体試作、他	・検査 ・ラボ用現像 ・マスクレス露光、他	<ul style="list-style-type: none"> ナノシステムソリューションズ リソテックジャパン ジャパנקリエイト
	フォトマスク	・レガシー半導体用フォトマスク ・FPD用フォトマスク	検査関連、他	ブイ・テクノロジー
FPD	検査	LCD、OLED、その他の用途	検査関連、他	<ul style="list-style-type: none"> ブイ・テクノロジー オー・エイチ・ティー
	露光	LCD、その他の用途	カラーフィルター露光、 光配向露光、他	ブイ・テクノロジー
	アフターサービス	LCD、OLED、その他の用途	製品のサービス、他	ブイ・テクノロジー、他

・ 将来見通し

本資料に記載されている当社の計画、戦略、見通し及びその他の歴史的事実でないものは、将来に関する見通しであり、これらは現在入手可能な期待、見積、予想に基づいています。これらの期待、見積、予想は、経済情勢・市況の変化、競争環境の変化、顧客のある国の政策変化、係争中及び将来の訴訟の結果など多くの潜在的リスク、不確実な要素、過程の影響を受けますので、実際の業績は見通しから大きく異なる結果となる可能性があります。従って、これら将来予想に関する記述に全面的に依拠することは差し控えて頂きますようお願いいたします。また、当社は新しい情報、将来の出来事などにに基づきこれらの将来予測を更新する義務を負うものではありません。

・ 数字の処理

記載された金額は、単位未満を切り捨て処理、比率は単位金額で処理した結果を四捨五入している為、内訳と一致しない場合があります。

・ 事業セグメントの構成

✓ 半導体・フォトマスク装置事業

半導体製造工程における製造装置、検査装置及びフォトマスク用装置等の開発・設計・製造・販売・関連サービス、及びPCB用装置で構成されています。

✓ FPD装置事業

FPD製造工程における製造装置、検査装置等の開発、設計、製造、販売、関連サービス及びOLED用蒸着マスクをはじめとする部材等で構成されています。

お問合せ先

IR室

vtj-ir@vtec.co.jp